

Solder Fortification®

预成型焊片

简介

在电子制造中，正确的焊料量对保证焊点的强度至关重要。然而，微小化趋势（如钢网厚度减小和元件排列更紧凑）使其变得更加困难。**Solder Fortification® 预成型焊片**能为这些极具挑战性的问题提供解决方案。

Solder Fortification® 预成型焊片一般为不含助焊剂的长方形或者圆环状的合金片。这种预成型焊片通过标准的贴片机放在已沉积的焊锡膏上。因为预成型焊片和焊锡膏的合金相同，这种预成型焊片的回流温度和焊锡膏一致，而在这个过程中，焊锡膏会提供必要的助焊剂。这种预成型焊片可在焊锡膏极限上增加焊料量，这对间距等于或小于0.3毫米的钢网非常重要。

特征

- 增加焊料量
- 提高跌落测试结果
- 助焊剂残留物的问题更少
- 减少返修
- 增强焊点的形状和量

优点

Solder Fortification® 预成型焊片的优点包括：

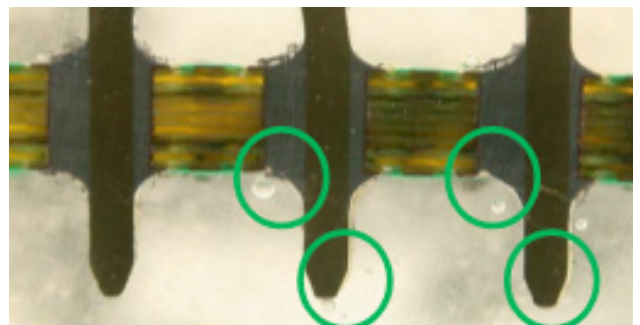
- 在焊锡膏极限上，增加焊料量
- 助焊剂残留物问题更少
- 消除昂贵或者耗时的工艺，如波峰焊和选择焊
- 更强的焊点可以帮助提高跌落测试结果
- 减少用于增加焊料量的返修和其他手工流程
- 焊点的形状和量增强，从而保证焊点满足IPC的要求

包装

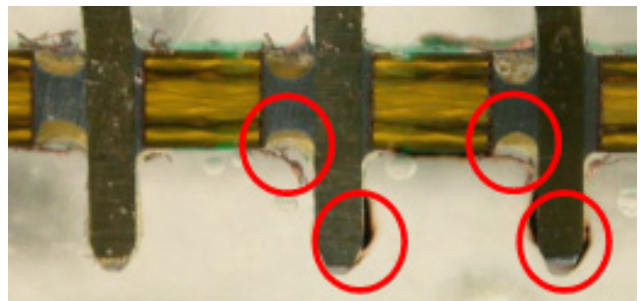
Solder Fortification® 预成型焊片使用卷带包装，方便直接使用标准贴片机。

合金

- SAC305
- SAC 387
- Sn63
- Sn62
- BiSn
- BiSnAg



Solder Fortification® 预成型焊片 + 焊锡膏的组合，可获得非常好的通孔焊点。



上图所示，是PIP后的焊点中的缺锡现象。同时请注意，还有过多的助焊剂残留物。

翻页 →

Solder Fortification® 预成型焊片

Solder Fortification® 解决方案

品名	尺寸	每卷的数量		参考重量 SAC 305 (克/片)
		7"	13"	
0201	0.010" x 0.020" x 0.010" 长方形 (0.254mm x 0.508mm x 0.254mm)	1k	50k	0.00024
0402	0.020" x 0.040" x 0.020" 长方形 (0.508mm x 1.01mm x 0.48mm)	1k	15k	0.00182
0603	0.030" x 0.060" x 0.031" 长方形 (0.76mm x 1.52mm x 0.787mm)	1k	15k	0.00672
				0.02410

技术服务

镭泰公司拥有经验丰富的国际工程师可为我们的客户提供深度技术协助。技术支持工程师深谙电子和半导体封装领域中材料科学应用的各个方面，其快速应答和随时提供现场技术支持的高品质服务设立了行业标杆。镭泰公司的技术支持工程师竭诚为您服务，将第一时间回应所有技术咨询。

安全说明书

如欲获取本产品的安全说明书，敬请访问：
<http://www.indium.com/sds>。



本产品说明书仅供参考，并不对所描述的性能做任何担保。具体质保信息请参见产品合同、发票或者发货单里的文字说明。除特别说明，镭泰公司的产品和解决方案均市场有售。

立即联络：china@indium.com

更多详情：www.indium.com

中国 +86 (0) 512 628 34900 • 亚洲 +65 6268 8678 • 欧洲 +44 (0) 1908 580400 • 美国 +1 315 853 4900



©2017 Indium Corporation